



#### RE900-04

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionss Platine für TSOP I 16, 24, 28, 36 (0,65 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 16,73 x 43,64 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00